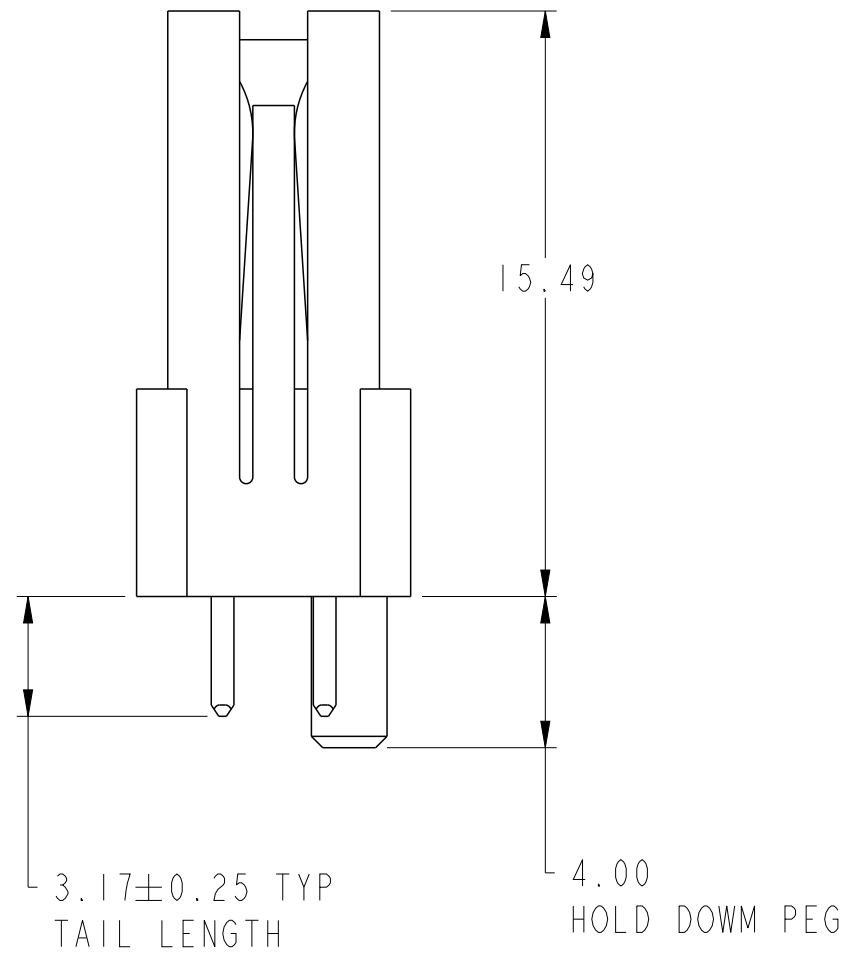
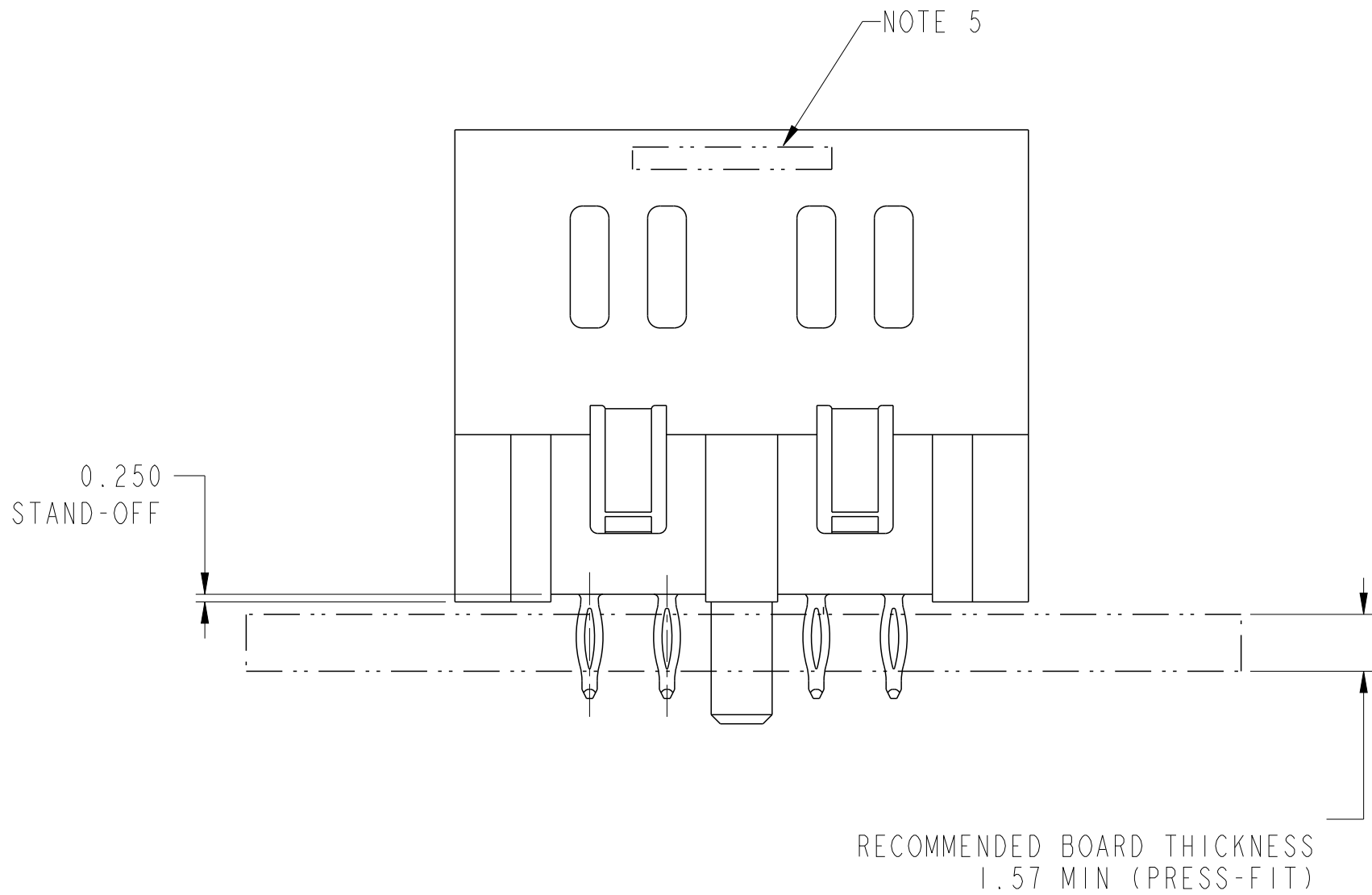
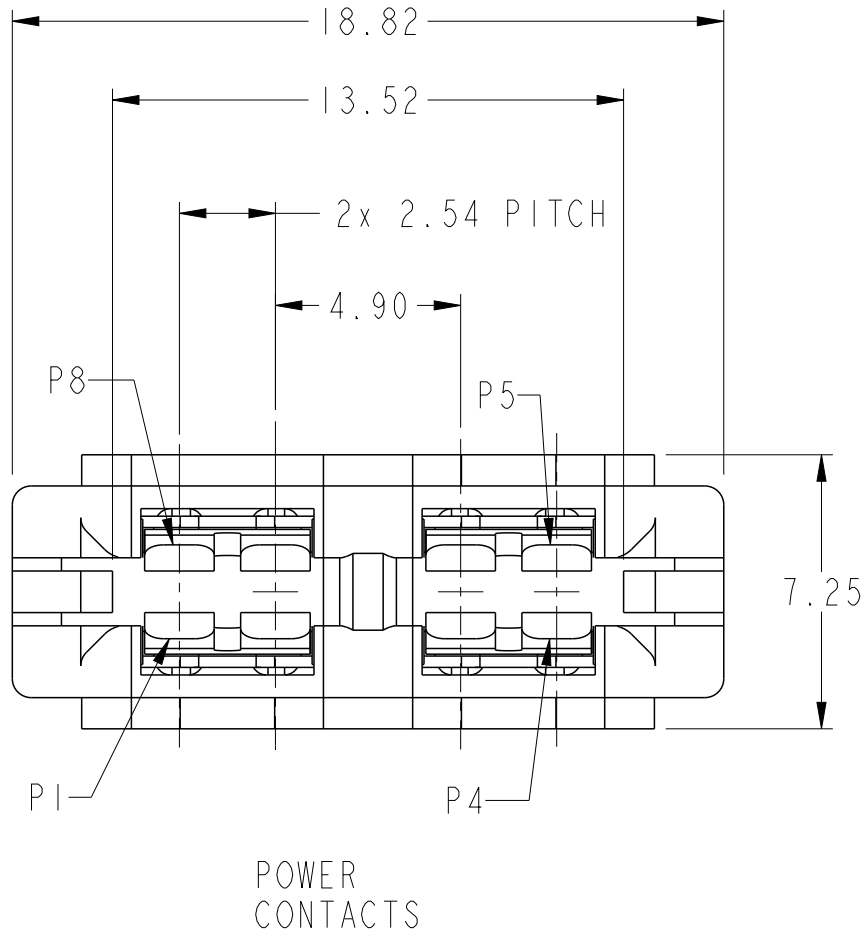
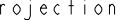
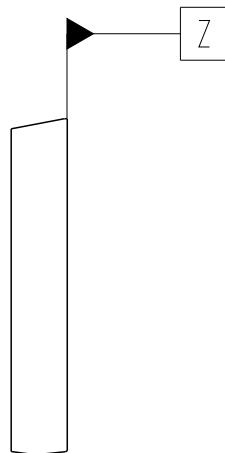
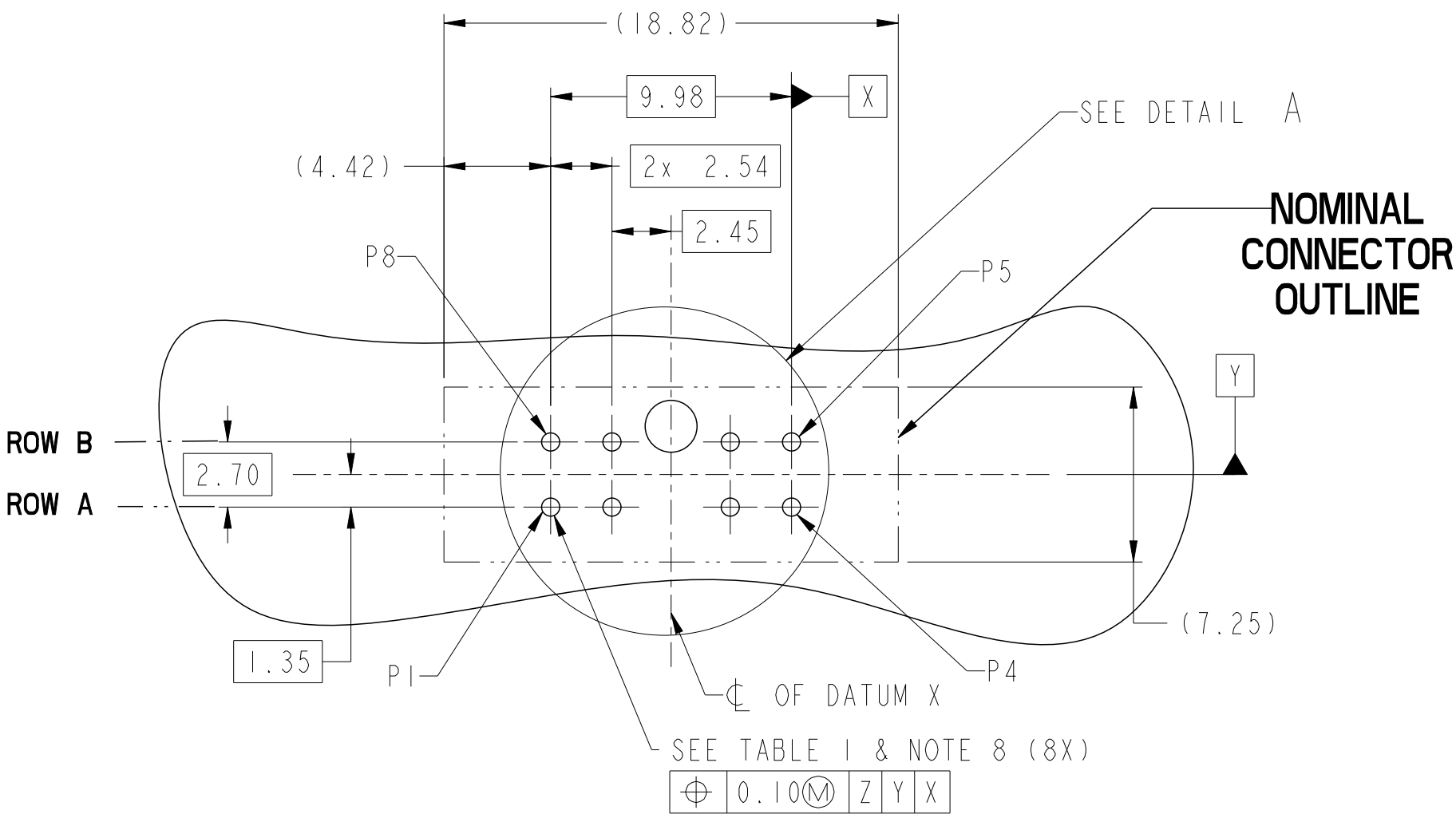


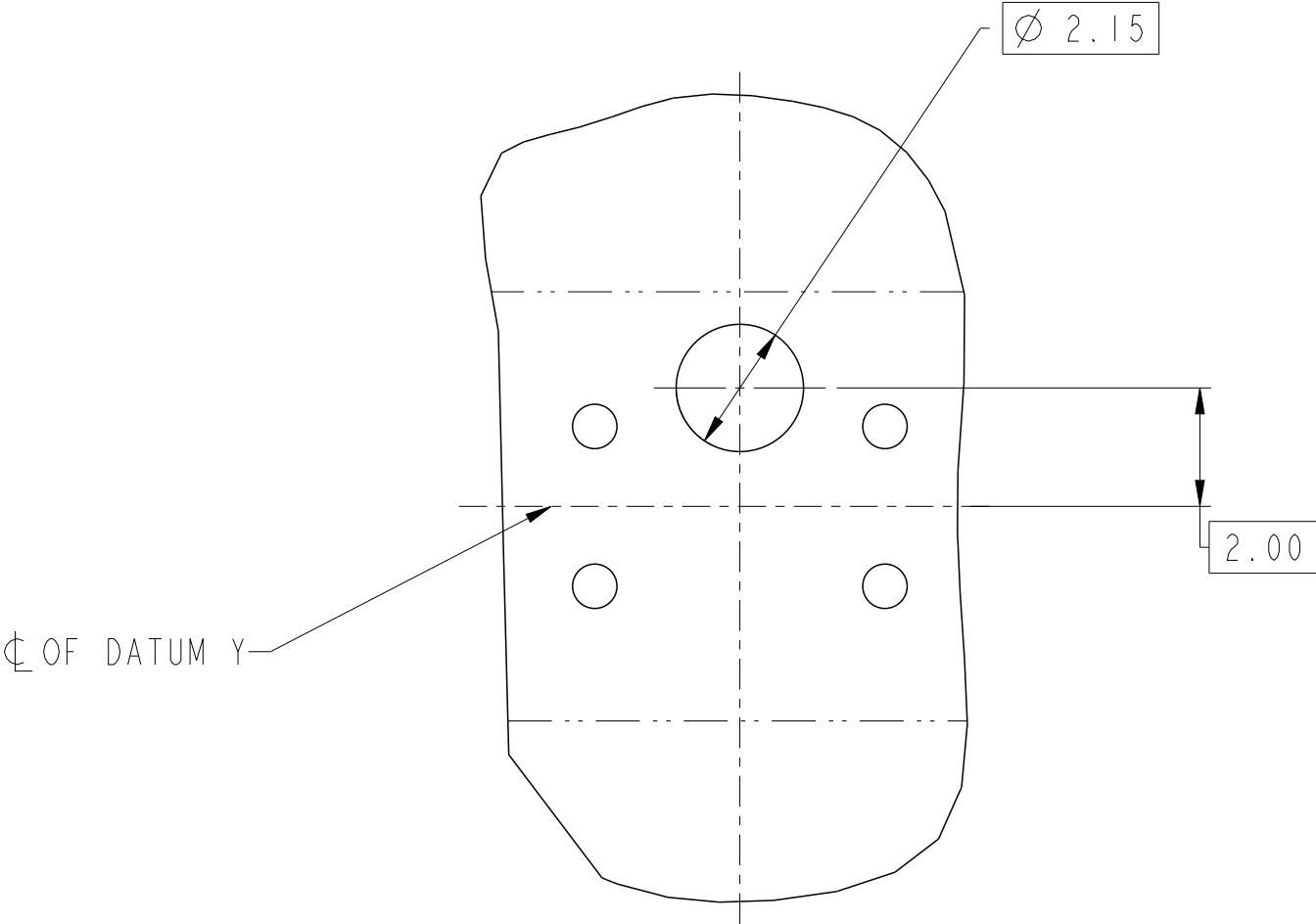
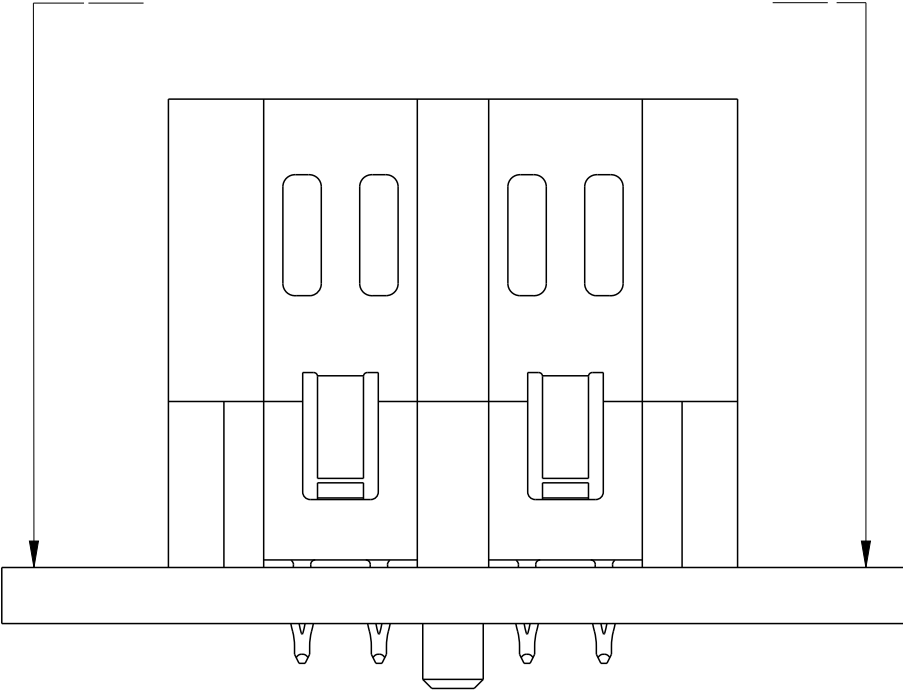
1	2
PART NUMBER	TAIL TYPE
10136109-001LF	PRESS FIT
10136109-002LF	SOLDER TAIL



spec ref		-		dr	Hai-Ling Liu	2015/07/09	projection		mm	size	A2	scale	5:1	
tolerance std		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		eng	Sunny2 Liu	2016/06/07					ecn no	ELX-DG-24234-1		
ISO 406				chr	Terris Liu	2016/06/06	product family		CARD EDGE	rel level	Released			
ISO 1101				appr	Pei-Ming Zheng									
surface	linear	0.X	±0.5	Amphenol FCI	title	HPCE MEZZANINE 4LP WITH PEG				dwg no	10136109		rev	C
		0.XX	±0.25											
		0.XXX	±0.10											
ASME Y14.5	angular	0°	±2°		cat. no.	-	Product - Customer Drw				sheet 1 of 3			



RECOMMENDED PCB LAYOUT
VIEWED FROM CONNECTOR SIDE

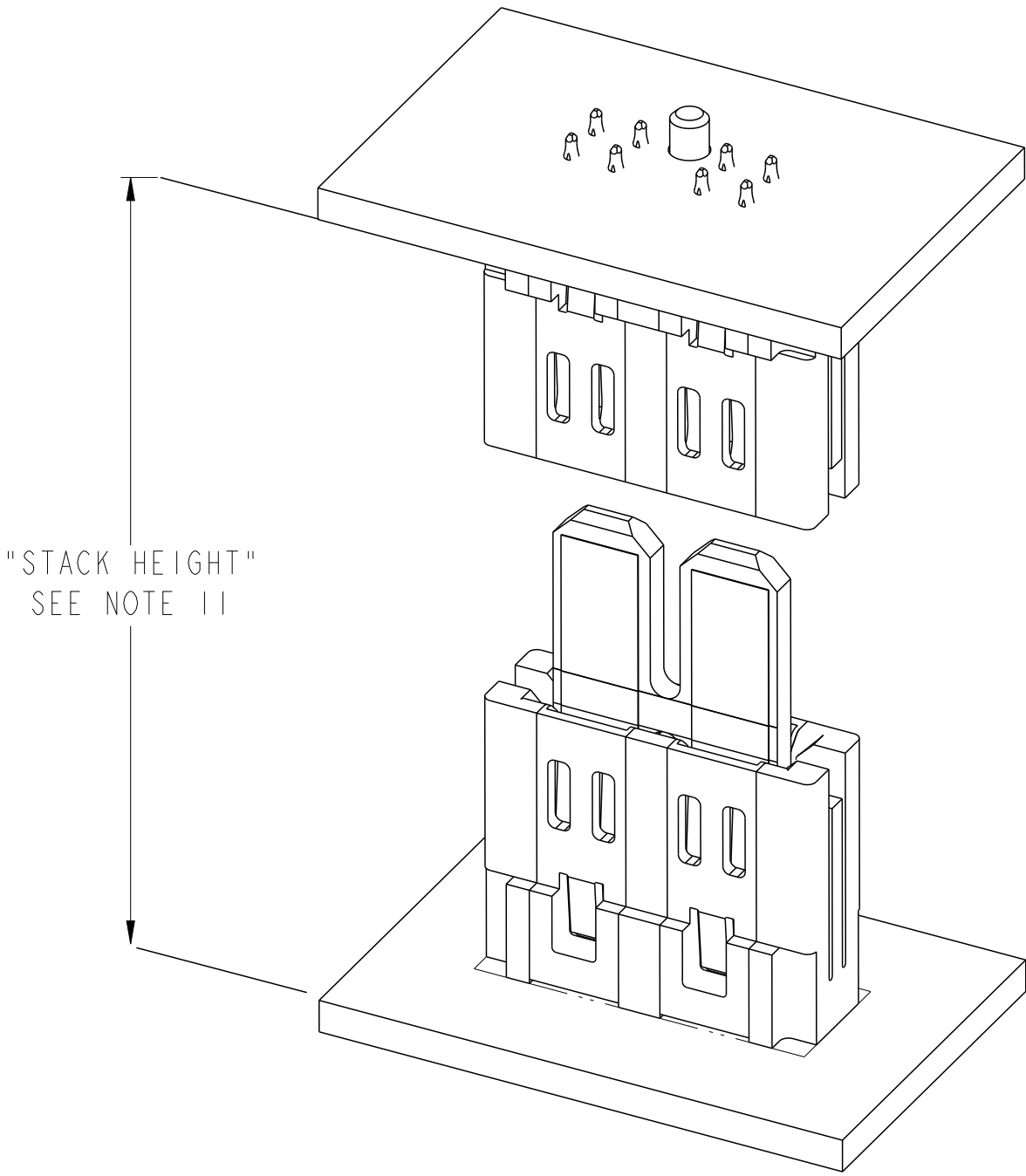


DETAIL A
SCALE 8:1

spec ref -				dr Hai-Ling Liu		2015/07/09		projection		mm		size A2		scale 2:1	
tolerance std ISO 406 ISO 1101				eng Sunny2 Liu		2016/06/07						ecn no ELX-DG-24234-1			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				chr Terris Liu		2016/06/16						rel level Released			
				appr Pei-Ming Zheng		2016/06/16						product family -			
surface ASME Y14.5		linear		Amphenol FCI		title HPCE MEZZANINE						dwg no 10136109		rev C	
		0.X ±0.5				4LP WITH PEG									
		0.XX ±0.25													
		0.XXX ±0.10													
angular		0° ±2°				cat. no. -		Product - Customer Drw						sheet 2 of 3	

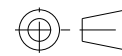
CONTACT TYPE	TOP LAYER DESCRIPTION	TABLE I (HPCE / PRESS-FIT TAILS) PLATED THROUGH-HOLE REQUIREMENTS				
		DRILLED HOLE DIAMETER	COPPER THICKNESS	TIN-LEAD THICKNESS	TIN THICKNESS	FINISHED HOLE DIAMETER
POWER	TIN-LEAD	0.81-0.86 (0.85 DRILL)	0.025 - 0.050	0.005 - 0.015	--	0.65 - 0.80
	IMMERSION TIN	0.81-0.86 (0.85 DRILL)	0.025 - 0.050	--	0.9 - 1.5um	0.70 - 0.80
	COPPER (SEE NOTE 8)	0.81-0.86 (0.85 DRILL)	0.025 - 0.050	--	--	0.70 - 0.80

CONTACT TYPE	TOP LAYER DESCRIPTION	TABLE I (HPCE / SOLDER TAILS) PLATED THROUGH-HOLE REQUIREMENTS				
		DRILLED HOLE DIAMETER	COPPER THICKNESS	TIN-LEAD THICKNESS	TIN THICKNESS	FINISHED HOLE DIAMETER
POWER	TIN-LEAD	1.10-1.16 (1.15 DRILL)	0.025 - 0.050	0.005 - 0.015	--	0.94 - 1.10
	IMMERSION TIN	1.10-1.16 (1.15 DRILL)	0.025 - 0.050	--	0.9 - 1.5um	0.94 - 1.10
	COPPER (SEE NOTE 8)	1.10-1.16 (1.15 DRILL)	0.025 - 0.050	--	--	0.94 - 1.10



NOTES:

1. CONNECTOR MATERIALS:
- HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMAL PLASTIC, BLACK
UL 94V-0 COMPLIANT
- CONTACTS: HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY.
2. CONTACT FINISH REF. GS-12-1261 SECTION 5.3.
3. PRODUCT SPECIFICATION: GS-12-1261.
4. APPLICATION SPECIFICATION: GS-20-128.
5. PRODUCT MARKING ON HOUSING IN AREA SHOWN SHOULD MEET AFCI SPECIFICATION GS-24-007..
6. PACKAGING MEETS FCI SPECIFICATION GS-14-937.
7. HOUSING COMPONENT WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 60 SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED, OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN.
8. COPPER PLATING THICKNESS IN CENTER OF VIA-HOLE CAN BE NO MORE THAN 0.003 LESS THAN OTHER AREAS.
9. ALL HOLE SIZES ARE FINISHED HOLE SIZES.
10. INTENDED USE: TWO ASSEMBLIES (P/N 10134991 MATE TO 10136109) MEZZANINE STACKED USING PCB TO CONTROL STACK HEIGHT.
DIM "L" + 10.98mm = FINAL MEZZANINE STACK HEIGHT.
DIM "L" RANGES FROM 21.02-46.62 mm .
11. SEE DRAWING 10135823 FOR MATING PCB DETAIL
12. A SYMBOL  WILL BE NEXT TO ANY DIMENSION, VIEW, OR NOTE WHICH HAS BEEN MODIFIED WITH THE CURRENT DRAWING REVISION.

spec ref -				dr		Hai-Ling Liu		2015/07/09		projection		mm		size		A2		scale		1:1	
tolerance std				eng		Sunny2 Liu		2016/06/07						ecn no		ELX-DG-24234-1					
ISO 406				chr		Terris Liu		2016/06/16						rel level		Released					
ISO 1101				appr		Pei-Ming Zheng		2016/06/16						product family		-					
surface		linear		0.X		±0.5		Amphenol FCI		title		HPCE MEZZANINE		dwg no		10136109		rev		C	
ASME Y14.5				0.XX		±0.25															
				0.XXX		±0.10															
		angular		0°		±2°		cat. no.		-		Product - Customer Drw		sheet 3 of 3							

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9